

第 24 回 半導体・オブ・ザ・イヤー2018

応募用紙

(1/2)

■ 応募部門 : 該当するカテゴリー欄にチェックを入れてください。

※2017年4月～2018年3月までに新製品(バージョンアップ等を含む)として発表された製品・技術が対象となります。

半導体デバイス部門 半導体製造装置部門 半導体用電子材料部門

■ 製品名・技術名

--

■ 製品・技術の発表時期

--

■ 追加資料 ある ない

※製品カタログもしくはニュースリリースなどがございましたら、選考に使用させていただきますのでご提供下さい。

(ふりがな) 会社名			
TEL		FAX	
(ふりがな) 申し込み担当者名		所属 役職	
所在地			
会社設立年月日		従業員数	
E-mail		URL	

●複数の製品を応募される場合は、本用紙をコピーのうえご使用下さい。

●E-mai でも応募可能です。応募内容を scnw@sangyo-times.co.jp までお送り下さい。

	(株)産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)	
問合せ	〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル 3階	応募期限
送付先	Tel.03-5835-5896 Fax.03-5835-5496 担当:津村	4月13日
	E-mail : scnw@sangyo-times.co.jp	

第 24 回 半導体・オブ・ザ・イヤー2018

応募用紙

(2/2)

■ 応募製品・技術の情報

1) 製品・技術の概要・性能・用途

2) 製品・技術の新規性

3) 製品・技術の納入・導入実績

(株)産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)

問合せ 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル3階

送付先 Tel.03-5835-5896 Fax.03-5835-5496 担当:津村

E-mail : scnw@sangyo-times.co.jp

応募期限

4月13日